

概述

OC5138T 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。

OC5138T 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz。

OC5138T 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

OC5138T 集成了高低亮功能，可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式，MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。

OC5138T 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等，减少外围元件并提高系统可靠性。

OC5138T 采用 SOT23-6 封装。

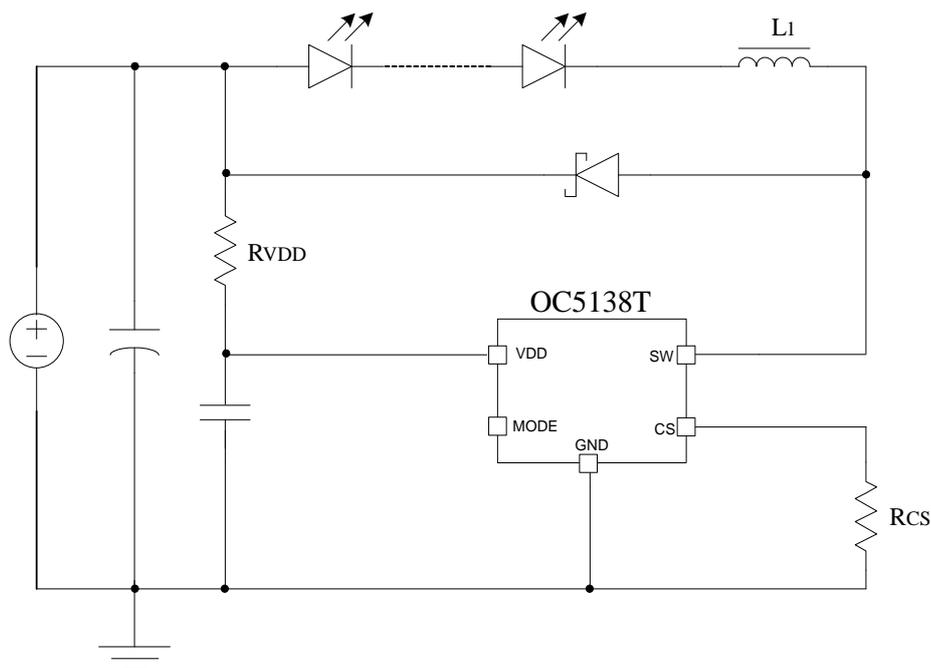
特点

- ◆ 内置 90V MOS
- ◆ 宽输入电压范围：8V~80V
- ◆ 输出电流范围：100mA~800mA
- ◆ 高效率：可高达 93%
- ◆ 工作频率：140KHz
- ◆ 支持高低亮工作模式
- ◆ 平均电流检测
- ◆ 智能过温保护
- ◆ 内置 VDD 稳压管

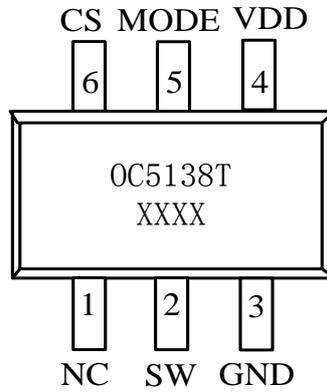
应用

- ◆ 电动自行车、摩托车灯
- ◆ 汽车照明
- ◆ 直流或交流输入 LED 驱动
- ◆ 大功率 LED 照明
- ◆ LED 背光

典型应用电路图



封装及管脚分配



管脚描述

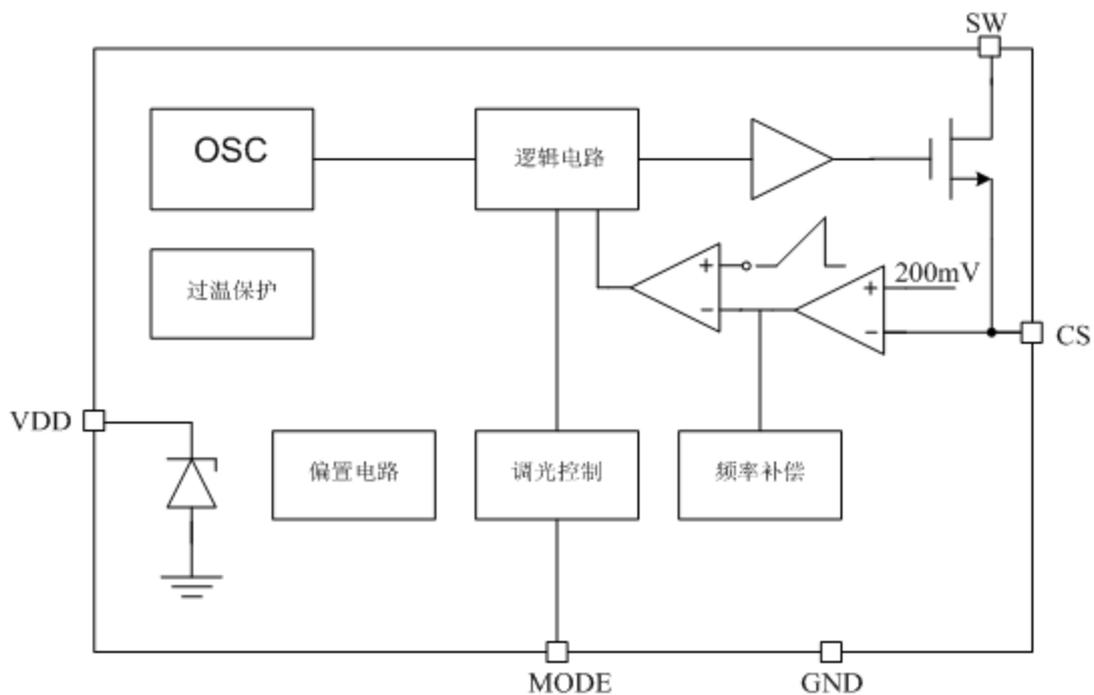
管脚号	管脚名	描述
1	NC	悬空不接
2	SW	开关脚，接内置 MOS 管漏极。
3	GND	接地
4	VDD	芯片电源
5	MODE	高低亮选择脚。MODE 悬空或者接地 LED 全亮输出，MODE 接高电平 LED 半亮输出。
6	CS	电感电流检测脚

极限参数 (注1)

符号	描述	参数范围	单位
VDD	VDD 端最大电压	6	V
V _{MAX}	MODE 和 CS 脚的电压	-0.3~VDD+0.3	V
VSW	SW 脚最大电压	90	V
P _{SOT23-6}	SOT23-6 封装最大功耗	0.3	W
T _J	工作结温范围	-40~125	°C
T _{STG}	存储温度范围	-40~120	°C
T _{SD}	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	240	°C
V _{ESD}	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

内部电路方框图



电特性

除非特别说明, $V_{DD} = 5.8V$, $T_A = 25^{\circ}C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 钳位电压	V_{DD}	$I_{VDD} < 10mA$		5.8		V
欠压保护电压	V_{DD_UVLO}	V_{DD} 上升		4.1		V
欠压保护迟滞	V_{DD_HYS}			0.4		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}	$F_{OP} = 140KHz$		1.8		mA
待机输入电流	I_{INQ}	无负载		500		uA
电流采样						
VCS 均值	V_{CS}		190	200	208	mV
工作频率						
工作频率	FS			140		KHz
MODE 阻抗						
MODE 下拉电阻	R_{MODE}			80		K Ω
内置 MOS						
MOS 耐压	VDS		85			V
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		$^{\circ}C$

应用指南

工作原理

OC5138T 采用固定频率的 PWM 工作模式，典型工作频率为 140KHz。OC5138T 采用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性。

输出电流设置

LED 输出电流由电流采样 R_{CS} 设定：

$$I_{LED} = \frac{0.2}{R_{CS}}$$

电感取值

为保证系统的输出恒流特性，电感电流应工作在连续模式，要求的最小电感取值为：

$$L_1 > 4V_{LED} * (1 - V_{LED} / V_{IN}) * R_{CS} / FS$$

MODE 脚设置

OC5138T 可通过 MODE 脚进行高低亮功能选择。MODE 脚悬空或接地，则工作在高亮模式，LED 全亮输出。MODE 脚接 VDD，则工作在低亮模式，LED 输出电流减半。

芯片布局考虑

电流检测电阻 R_{CS} 到芯片 CS 引脚以及 GND 引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电阻对输出电流精度的影响。

供电电阻选择

OC5138T 通过供电电阻 R_{VDD} 对芯片 VDD 供电。

$$R_{VDD} = \frac{V_{IN} - V_{DD}}{I_{VDD}}$$

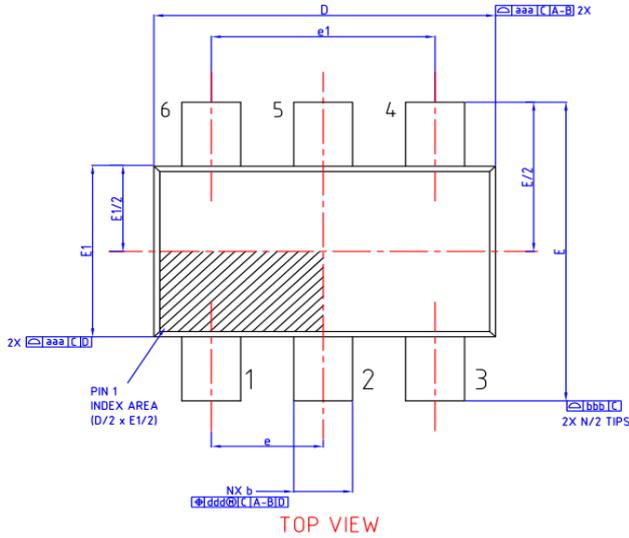
其中 VDD 取 5.8V， I_{VDD} 典型值取 2mA， V_{IN} 为输入电压。芯片内部接 VDD 脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA，应注意 R_{VDD} 的取值不能过小，以免流入 VDD 的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息

SOT23-6 封装参数



DIMENSION IN MM(SOT23.6L)			
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.95	1.30	1.40
A1	0.050	0.100	0.150
A2	0.90	1.20	1.25
A3	0.783BSC		
A4	0.417BSC		
b	0.30	0.35	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
c	0.08	0.152	0.220
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
e	0.95BSC		
e1	1.90BSC		
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
L	0.30	0.45	0.60
L1	0.60REF		
L2	0.25BSC		
θ	0°	4°	8°
$\theta1$	5°	10°	15°

SYMBOL	TOLERANCES OF FORM AND POSITION
aaa	0.15
bbb	0.20
ccc	0.10
ddd	0.20

NOTE:

1. Body dimension not include mold flash or protrusion
Mold flash or protrusion shall not exceed 0.15mm per side.
2. Falls within JEDEC MO-178 variation AB
3. Basic common dimension sheet plating thickness for pre-plating
For Tin plating product ,Tin plating thickness is 0.01mm - 0.018mm

